

平成 23 年 11 月 9 日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社  
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)  
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 岸本 昌利  
TEL (075) 692-0251

## 新製品「YPM1150」販売開始に関するお知らせ

当社は、独自の「小型・高精密プレス機構」と「中央加圧方式」の開発により、大判リードフレーム・基板に対応し、さらに変形量の抑制・有効盤面の極大化を実現した新製品「YPM1150」の販売を開始しますので、その概要をお知らせいたします。

### 記

#### 1、開発の背景

半導体業界のコスト競争は激しく、各半導体メーカーはリードフレーム・基板の大判化によるコストダウンを急速に進めております。そのためモルディング装置では、プレス機構を大型化することで大判化に対応しておりましたが、従来のプレス機構のままでは装置自体が大型化し、工場での設置可能台数を制約することから、半導体メーカーが望むコストダウンを実現できない問題がありました。

当社はホールドフレーム構造を採用した独自の「小型・高精密プレス機構」と「中央加圧方式」の開発に成功し、大判リードフレーム・基板に対応した量産用装置であると同時にフットプリント（設置面積）を大幅に抑制し、さらに半導体モルディングプロセスにおける変形量の抑制・有効盤面の拡大を可能とする新しいモルディング装置を実現いたしました。この新製品により、半導体メーカー各社の生産コスト削減に大きく貢献できるものと考えております。

#### 2、製品概要と販売計画等

##### (1) 製品概要

- ・対応リードフレーム 100mm×300mm
- ・中央加圧方式（ホールドフレーム構造を採用）によりリードフレーム均一クランプを実現
- ・サイドゲート、トップ/エッジゲート 全てに対応可能
- ・当社従来機比35%以上の生産効率向上
- ・プレス機構の小型化・剛性向上

##### (2) 販売計画

- ・販売開始時期 2011年12月
- ・販売目標 年間50台（2013年3月期）

以上



新製品 「 YPM1150 」